

2017-2022年中国晶圆代工 行业深度调研与行业竞争对手分析报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2017-2022年中国晶圆代工行业深度调研与行业竞争对手分析报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/jixie/K771618X3V.html>

报告价格：印刷版：RMB 7000 电子版：RMB 7200 印刷版+电子版：RMB 7500

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

报告目录：

第一章晶圆制造简介21

第一节晶圆制造流程21

第二节晶圆制造成本分析27

第二章半导体市场32

第一节2017-2022年半导体产业预测32

第二节2016年半导体市场下游预测34

第三节全球晶圆代工产业现状35

第四节全球半导体制造产业38

一、全球半导体产业概况38

二、全球晶圆代工行业概况39

第五节中国半导体产业与市场44

一、中国半导体市场44

二、中国半导体产业47

三、中国ic设计产业56

四、中国半导体产业发展趋势59

第三章晶圆代工产业简介61

第一节晶圆制造工艺简介61

第二节全球晶圆产业及主要厂商简介62

第三节中国半导体产业政策环境70

第四节中国晶圆制造业现状及预测73

第四章晶圆厂研究76(ZYWZY)

一、中芯国际76

(一) 企业偿债能力分析77

(二) 企业运营能力分析79

(三) 企业盈利能力分析82

二、上海华虹nec电子有限公司83

- (一) 企业偿债能力分析85
- (二) 企业运营能力分析87
- (三) 企业盈利能力分析90
- 三、上海宏力半导体制造有限公司92
 - (一) 企业偿债能力分析93
 - (二) 企业运营能力分析95
 - (三) 企业盈利能力分析98
- 四、华润微电子99
 - (一) 企业偿债能力分析100
 - (二) 企业运营能力分析102
 - (三) 企业盈利能力分析105
- 五、上海先进半导体106
 - (一) 企业偿债能力分析107
 - (二) 企业运营能力分析109
 - (三) 企业盈利能力分析112
- 六、和舰科技(苏州)有限公司113
 - (一) 企业偿债能力分析114
 - (二) 企业运营能力分析116
 - (三) 企业盈利能力分析119
- 七、bcd(新进半导体)制造有限公司120
 - (一) 企业偿债能力分析121
 - (二) 企业运营能力分析123
 - (三) 企业盈利能力分析126
- 八、方正微电子有限公司127
 - (一) 企业偿债能力分析128
 - (二) 企业运营能力分析130
 - (三) 企业盈利能力分析133
- 十、南通绿山集成电路有限公司134
 - (一) 企业偿债能力分析135
 - (二) 企业运营能力分析137
 - (三) 企业盈利能力分析140
- 十一、纳科(常州)微电子有限公司141

- (一) 企业偿债能力分析144
- (二) 企业运营能力分析146
- (三) 企业盈利能力分析149
- 十二、珠海南科集成电子有限公司150
 - (一) 企业偿债能力分析151
 - (二) 企业运营能力分析153
 - (三) 企业盈利能力分析156
- 十三、康福超能半导体(北京)有限公司157
 - (一) 企业偿债能力分析157
 - (二) 企业运营能力分析159
 - (三) 企业盈利能力分析162
- 十四、科希-硅技半导体技术第一有限公司163
 - (一) 企业偿债能力分析163
 - (二) 企业运营能力分析165
 - (三) 企业盈利能力分析168
- 十五、光电子(大连)有限公司170
 - (一) 企业偿债能力分析170
 - (二) 企业运营能力分析172
 - (三) 企业盈利能力分析175
- 十六、西安西岳电子技术有限公司176
 - (一) 企业偿债能力分析177
 - (二) 企业运营能力分析179
 - (三) 企业盈利能力分析182
- 十七、吉林华微电子股份有限公司183
 - (一) 企业偿债能力分析185
 - (二) 企业运营能力分析187
 - (三) 企业盈利能力分析190
- 十八、丹东安顺微电子有限公司191
 - (一) 企业偿债能力分析191
 - (二) 企业运营能力分析193
 - (三) 企业盈利能力分析196
- 十九、敦南科技198

- (一) 企业偿债能力分析199
- (二) 企业运营能力分析200
- (三) 企业盈利能力分析203
- 二十、福建福顺微电子205
 - (一) 企业偿债能力分析206
 - (二) 企业运营能力分析208
 - (三) 企业盈利能力分析211
- 二十一、杭州立昂212
 - (一) 企业偿债能力分析213
 - (二) 企业运营能力分析215
 - (三) 企业盈利能力分析218
- 二十二、杭州士兰集成电路219
 - (一) 企业偿债能力分析220
 - (二) 企业运营能力分析222
 - (三) 企业盈利能力分析224
- 二十三、hynix-st半导体公司226
 - (一) 企业偿债能力分析226
 - (二) 企业运营能力分析228
 - (三) 企业盈利能力分析231
- 二十四、台积电232
- 二十五、联电237
- 二十六、特许239
- 二十七、东部亚南dongbuanam240
- 二十八、世界先进241
- 二十九、jazz半导体241
- 三十、magnachip242
- 三十一、silterra243
- 三十二、x-fab245
- 三十三、stsilicon246
- 三十四、towersemiconductor246
- 三十五、episiltechnologies247
- 三十六、ibm247

图表目录：

图表1晶圆制造工艺流程21

图表2晶圆尺寸变化影响加工成本趋势分析27

图表32016年度全球营收前13的晶圆代工企业35

图表42017-2022年大陆ic内需市场规模变化与预测36

图表5主要代工企业产能分布及收益情况41

图表6集成电路技术节点及其对应研发和建厂费用43

图表7全球半导体市场规模超过3000亿美元47

图表8半导体产品种类繁多48

图表9全球半导体分产品市场占比48

图表10中国大陆半导体市场规模近4000亿元49

图表11全球半导体产业区域结构发生巨大变化50

图表12北美半导体设备制造商bb值51

图表13半导体产业链51

图表14近期或者未来有望在a股上市的半导体厂商52

图表15半导体产业链上封测环节技术壁垒相对较低53

图表16封测环节在半导体产业链中的相对进入壁垒54

图表17集成电路封测行业一直占据行业主导地位55

图表18国内十大半导体封装测试企业56

图表192016年全球晶圆代工排名63

图表202012-2016年全球前三大半导体厂商营收与成长趋势64

图表21全球半导体厂商资本支出占营收比例之比较65

图表22前三大半导体厂商资本支出与占营收比例趋势66

图表23全球半导体厂商资本支出集中程度分析67

图表24半导体设备厂商于18寸晶圆生产设备投资考虑情境分析68

图表25全球半导体设备产业版图的变化69

图表26国内政策对集成电路产业大力支持71

图表27国内半导体进口金额超2000亿美元71

图表28国内集成电路未来三阶段发展目标73

图表29近3年中芯国际有限公司资产负债率变化情况77

图表30近3年中芯国际有限公司产权比率变化情况78

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/jixie/K771618X3V.html>